

2024 年度江苏省科学技术奖推荐项目公示内容

一、申报类别：江苏省科技进步奖

二、项目名称：面向集成电路高性能制造的衬底抛光机理、工艺及测试方法

三、提名单位：无锡市科学技术局

提名等级：二等奖及以上

四、公示日期：2025.06.05 - 2025.06.11

五、完成人：樊成、钱鹏江、姚健、张凯虹、梁福生、奚留华、王钊、谢杰

六、完成单位：无锡中微腾芯电子有限公司、苏州大学、江南大学

七、主要知识产权和标准规范目录：

序号	知识产权 (标准) 类别	知识产权 (标准) 具体名称	国家 (地区)	授权号(标 准编号)	授权(标 准发布) 日期	证书编号 (标准批准 发布部门)	权利人 (标准起草单位)	发明人 (标准起草 人)	知识产权 (标准) 有效状态
1	发明专利	使用气囊抛光处理非球面的路径生成方法	中国	ZL2018114211942.7	2019.11.29	3615387	苏州大学	樊成, 张雷, 赵启智, 陆耀	有效
2	发明专利	Apparatus and method for polishing intraocular lens by utilizing electrorheological effect	美国	US12, 023, 774B2	2024.07.02	/	苏州大学	樊成, 张雷, 薛曹阳, 齐学	有效

3	发明专利	球形抛光头氧化铈抛光液斜轴抛光加工表面形貌预测方法	中国	ZL202411660222.6	2025.03.21	7816075	苏州大学	樊成, 王钊, 陈涛, 梁福生, 吉伟, 孟彬彬, 张振宇, 赵枫, 孟凡宁	有效
4	发明专利	一种区块链多模态数据异常检测方法	中国	ZL202410935056.X	2024.07.12	7496372	江南大学, 苏州大学, 吉林大学, 昆山微电子技术研究院	钱鹏江, 姚健, 樊成, 张冠宇, 周玲, 刘洋, 方伟, 蒋亦樟, 王闯	有效
5	发明专利	一种多层堆叠的3D-SIP芯片测试方法	中国	ZL201910024235.7	2022.03.29	5035151	无锡中微腾芯电子有限公司	张凯虹, 徐德生, 奚留华, 武乾文	有效
6	发明专利	基于归一法结合欧式距离函数的集成电路数据筛选方法	中国	ZL201811331833.0	2020.10.23	4047225	无锡中微腾芯电子有限公司	奚留华, 张凯虹	有效
7	发明专利	一种基于迁移学习的多尺度智能决策方法	中国	ZL202411284257.4	2024.11.15	7521538	江南大学, 吉林大学, 苏州大学	钱鹏江, 张冠宇, 姚健, 樊成, 蒋鑫, 蒋亦樟, 方伟, 刘丽, 刘洋, 梁福生, 顾逸, 张欣, 王闯	有效
8	发明专利	一种集成电路测试数据的筛选方法及装置	中国	ZL201711280543.3	2021.05.04	4399414	无锡中微腾芯电子有限公司	奚留华	有效
9	发明专利	一种用于3D-SIP芯片测试向量压缩的方法及系统	中国	ZL201910086847.9	2021.05.28	4445399	无锡中微腾芯电子有限公司	奚留华, 张凯虹, 徐德生, 武乾文	有效

10	发明专利	一种用于多存储芯片测试的方法	中国	ZL201910150254.4	2021.09.07	4667553	无锡中微腾芯电子有限公司	奚留华, 张凯虹, 徐德生, 常艳昭, 苏洋	有效
----	------	----------------	----	------------------	------------	---------	--------------	------------------------	----